

CPU散热垫|高导热硅胶片|固态散热硅脂

产品名称	CPU散热垫 高导热硅胶片 固态散热硅脂
公司名称	深圳三一导热材料有限公司
价格	.10/PCS
规格参数	导热系数:3.0 型号:LG300 耐温:40~220
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道环观南路茂源工业园B1栋2楼
联系电话	0755-29082440 13600411602

产品详情

【产品说明】 免费索样联系林生：40000-12580；手机：13600411602；qq:875793380

高导热硅胶片，具有非常好的高导热率和使用依顺性，在界面缝隙填充材料中具有无与伦比的导热率。高导热硅胶片特点优势：高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应、用环境、良好的热传导率、电气绝缘、满足rohs及ul的环境要求、天然粘性。随着电子产品的芯片的高度集成，功能要求越来越多，体积要求越来越小。高性能的元器件在高速度运行下会产生大量的热,这些热量必须立即去除以保证元器件能在正常工作温度下以最高效率运行.因此热成为了众多工程师必须课和严峻的挑战，同时传导相关技术随着电子工业的发展不断地受到重视。比如led行业灯具温度过高光衰问题，电脑当机问题等。

高导热硅胶片典型应用：笔记本电脑、通讯硬件设备、高速硬盘驱动器、汽车发动机控制模块、微处理器，记忆芯片及图形处理器、移动设备。

高导热硅胶片基本规格：200mm*400mm，300mm*400mm；可依使用规格裁成具体尺寸。厚度：0.3-5mm

高导热硅胶片物理特性参数表：

测试项目	测试方法	单位	lg系列测试值	

			Ig600测试值	Ig50
颜色 color	visual		蓝色/土红	黄
厚度 thickness	astm d374	mm	0.25~5.0	0.
比重 specific gravity	astm d792	g/cm3	2.85	
硬度 hardness	astm d2240	shore c	20/30	
抗拉强度 tensile strength	astm d412	kg/cm2	55	
耐温范围 continuous use temp	en344		-40~220	-4
体积电阻 volume resistivity	astm d257	-cm	3.1*10 ¹¹	3.
耐电压 voltage endurance	astm d149	kv/mm	>5.0	
阻燃性 flame rating	ul-94		94-v0	9
导热系数 conductivity	astm d5470	w/m-k	6.0	